

AMP

日本イー・エム・ピー株式会社
AMP (Japan), Ltd.

AMP タイプ II シールド付
0.8 mm フレーム・キット
型番 558133
取扱説明書

408-3328

改訂 0

作成年月日	5. Apr. '94
改訂年月日	

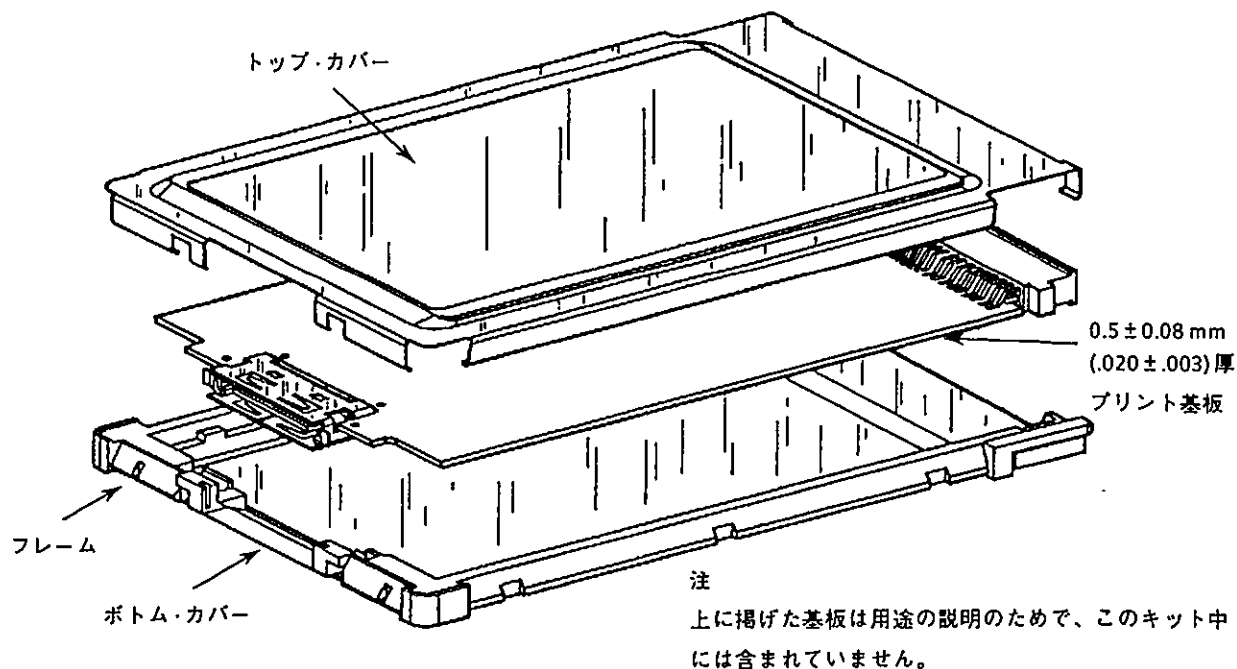


Fig. 1

1. はじめに

この取扱説明書は 15~33 極タイプ II シールド付 0.8 mm フレーム・キットの組立と分解の手順を説明しています。各キットには、トップとボトム・カバーとフレームが入れています。(Fig. 1 参照)

[注] 全寸法はインチ建て設計をミリメートル換算しています。

2. 組立ての手順

- ① Fig. 2 に示すようにプリント基板アセンブリをボトム・カバーの中に入れます。ケーブル・ヘッダーの側面タブとコンピュータの側面スロットは、フレームのスロットと嵌合します。コネクタの上部は、フレームの上部と同じ高さになるように、揃えて下さい。

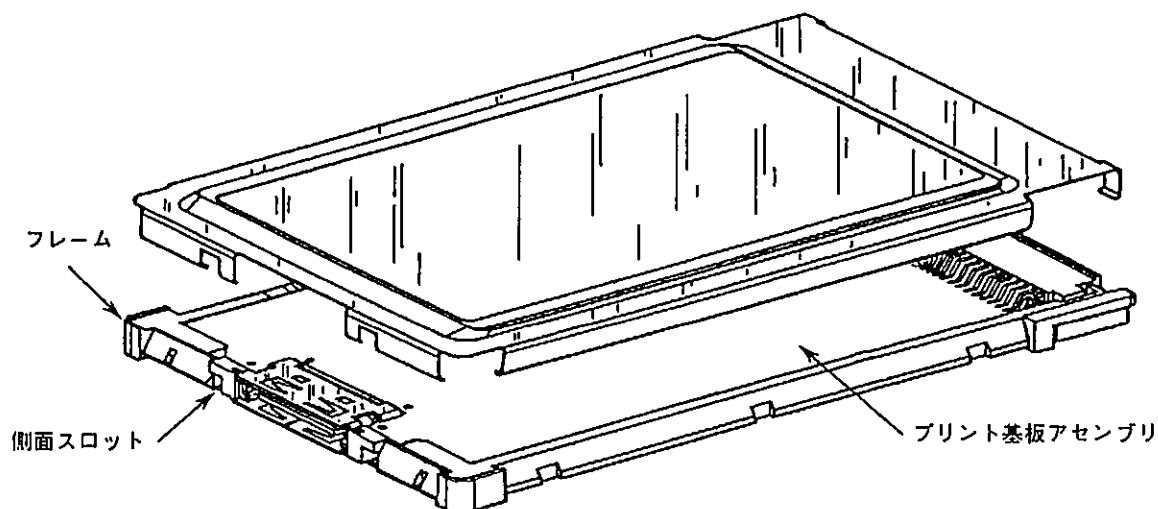


Fig. 2

- ② トップ・カバーをフレーム・アセンブリの底部の上にかぶせて合わせます。次に上部と底部がしっかりと嵌め合って両方が一体になるように、押しつけて合わせます。

トップ・カバーの全側面がフレームの上に重なって固定されているか確かめて下さい。

- ③ Fig.4で寸法を測定して、フレーム・キットの組立てが正しく行なわれたか確かめます。

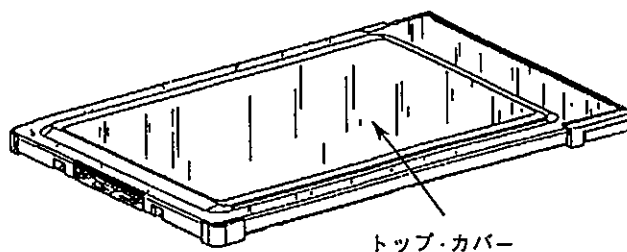


Fig. 3

- (a) もしもフレーム・キットにラベルを貼る

凹みがあるときは、部品間の寸法余裕は 0.08 mm (.003) 以下まで減少します。もしも絶縁フィルム等を使用されるときは、その厚さにより更に寸法余裕は減ることになります。

- (b) 絶縁フィルムの厚さの最大寸法は 0.08 mm (.003) になさるように、お奨めしています。

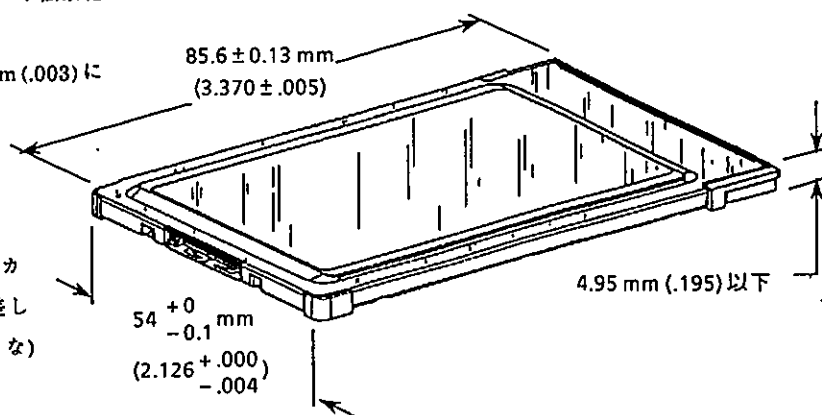
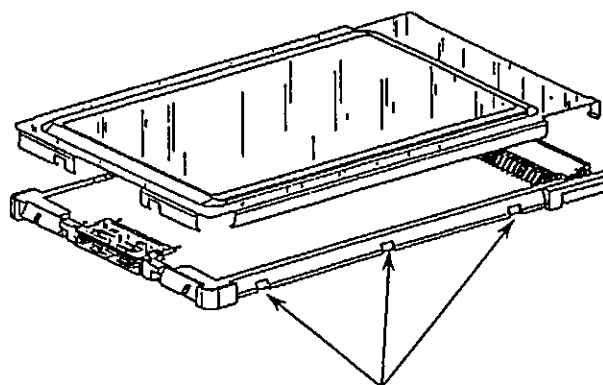


Fig. 4

3. 分解の手順

フレーム・キットを分解するときは、トップ・カバーをボトム・カバーから離すために、間に差し込んでこじるのに適した (例えばナイフのような) 薄肉のとがった工具を使います。

基板の両端の金属製タブを外し、次に Fig. 5 に図解した 6 個のノッチを一つずつ外しトップ・カバーをボトム・カバーから外します。トップ・カバーが外れて離れるまで一つずつ外して下さい。



両側面にノッチが3箇所つけてある。

Fig. 5